



電子情報技術産業協会技術レポート

Technical Report of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JEITA EDR-7719

**半導体ソケット位置決めシミュレーション
技術レポート**

[QFP タイプソケット]

Positioning simulation of semiconductor sockets

Technical reports

[Socket type QFP]

2014 年 10 月制定

作 成

半導体パッケージ技術小委員会

Technical Committee on Semiconductor Packaging

発 行

一般社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

まえがき

この技術レポートは、一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）電子デバイス部 半導体パッケージ技術小委員会 半導体ソケットサブコミティが作成したものである。

この技術レポートは、国際規格に整合するために制定された次の規格に基づいて、**JEITA TSC-16**（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式によって作成した技術レポートである。

この技術レポートは、著作権法によって保護されている著作物であるため、許可なくこの技術レポートの一部又はすべてを複製・転載することを禁止する。

この技術レポートは、その一部が工業所有権（特許権、実用新案権、意匠権など）に抵触する可能性に関係なく、作成されている。一般社団法人 電子情報技術産業協会は、このような工業所有権に係る確認について、責任はもたない。

電子情報技術産業協会技術レポート

半導体ソケット位置決めシミュレーション 技術レポート [QFP タイプソケット]

Positioning simulation of semiconductor sockets
Technical reports
[Socket type QFP]

1 適用範囲

この技術レポートは、**EIAJ ED-7311A** [集積回路パッケージ個別規格 (P-QFP)] で規定するプラスチッククワッドフラットパッケージ（以下、P-QFP）に適用されるテスト・アンド・バーンイン・ソケットの位置決めシミュレーションについて規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この技術レポートに引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、Amendment 又は追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は、その最新版（Amendment・追補を含む）を適用する。

a) JEITA 規格

- JEITA ED-7300A** 半導体パッケージ外形規格作成に関する基本事項
- JEITA ED-7303C** 集積回路パッケージの名称及びコード
- EIAJ ED-7311A** 集積回路パッケージ個別規格 (P-QFP)
- JEITA ED-7701A** 半導体ソケット用語 (BGA, LGA, FBGA 及び FLGA)

b) JEITA 文書

- JEITA TSC-16** 電子情報技術産業協会規格類の作成基準